

公司概況資料表

以下資料由慶康科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

(公司簡介)

風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：慶康科技股份有限公司 (股票代號：8098)

申請登錄：一般板 戰略新三板

董事長	杜家慶
總經理	杜家慶
資本額	新臺幣 98,019,730 元
輔導推薦證券商	國票綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	國票綜合證券股份有限公司 王俊傑(02)8502-1999 分機 7786
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

輔導推薦證券商認購慶康科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	國票綜合證券(股)公司	中國信託綜合證券(股)公司
認購日期	112年10月25日	
認購股數 (股)	260,000	40,000
認購占擬櫃檯 買賣股份總數 之比率	2.65%	0.41%
認購價格	每股 108 元	
認購價格之訂 定依據及方式	本輔導推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之股票價格，作為輔導推薦證券商認購慶康科技(股)公司(以下簡稱慶康科技或該公司)股票登錄興櫃登錄之	

參考價格訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本輔導推薦證券商與該公司共同議定之。

目前股票價值評估方法眾多，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，和整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價的調整。

(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。

(3)收益法則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

上述股票評價方法，其中因成本法係以歷史成本為計算之基礎，不足以代表成長性之股票未來的獲利水準，將可能低估成長型公司應有之價值。而收益法因預測期間較長，且預估所需參數較多，整體估測風險相對較高，亦難表達股票的合理價值。股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。慶康科技近年來營運規模逐漸成長，屬獲利穩定且成長型類股之族群，因此本輔導推薦證券商僅就本益比法作為該公司與櫃認購價格之評估基準。

慶康科技主要從事半導體關鍵零組件及系統設備之研發設計、生產及銷售；經檢視其相關產業及同業資料，以其產品種類與獲利比重、市場之競爭地位及公司的獲利能力等因素，選樣條件以半導體零組件產業的關聯性為考量基礎，並考量營運模式、產品性質及應用領域較為相近之業者。經選取目前上市櫃半導體類股中，業務涉足半導體零組件為採樣之選擇基礎，目前國內上櫃(市)公司中，瑞耘科技(股)公司(以下簡稱瑞耘科技，股票代號：6532)及翔名科技(股)公司(以下簡稱翔名科技，股票代號：8091)主要業務均為半導體零組件加工生產及半導體設備之代理，意德士科技(股)公司(以下簡稱意德士科技，股票代號：7556)主要業務則為提供半導體生產製程之精密零組件及材料。其中瑞耘科技與該公司主要產品均為應用於晶圓製造過程中之化學機械研磨製程之 Retaining Ring(晶圓夾持環)，而翔名科技主要產品為應用在晶圓製造過程中之擴散製程離子植入機消耗性零件，另意德士科技主要產品真空吸盤係應用在晶圓製造過程中之黃光製程與晶圓檢查之相關機台使用。由於該公司與瑞耘科技之主要產品相同，與翔名科技及意德士科技之主要產品均屬應用在晶圓生產製程中之各式零組件及耗材，性質相似，故選取瑞耘科技、翔名科技及意德士科技作為該公司採樣同業。

茲彙整該公司採樣同業公司及上櫃(市)半導體類股最近三個月之本益比如下表：

單位：倍

採樣公司 月份	瑞耘科技 (6532)	翔名科技 (8091)	意德士科技 (7556)	上櫃半導 體類股	上市半導 體類股
112年7月	12.83	10.93	18.57	19.81	14.18
112年8月	13.72	10.49	17.96	21.13	15.11
112年9月	13.89	10.54	18.26	21.52	14.61
平均本益比	13.48	10.65	18.26	20.82	14.63

資料來源：臺灣證券交易所網站及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站

由上表得知，因意德士科技及上櫃半導體類股最近三個月之平均本益比與其他同業相較均明顯偏高，故扣除上述兩者極端值之平均本益比後，該公司採樣同業及上市半導體類股最近三個月(112年7月~112年9月)之本益比區間在 10.65 倍~14.63 倍之間。若以該公司 111 年度及 112 年第二季經會計師查核簽證或核閱財務報告之最近四季 (111 年第三季至 112 年第二季) 稅後淨利為 144,603 千元，依擬興櫃掛牌時股份總數 9,802 仟股計算之每股盈餘 14.75 元為計算基礎，價格區間為 157.09 元~215.79 元。惟考量 112 年度半導體產業進入庫存調整期，整體半導體產業景氣及市場規模均較 111 年度下滑之產業及市場供需變化狀況，對該公司未來整體業績變化影響，加上考量興櫃市場股票流通性風險以 65 折計算之每股參考價格合理區間為 102.11 元~140.26 元，本輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股 108 元，介於合理價格區間內，故該公司興櫃認購價格之依據及議定方式應屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

慶康科技股份有限公司設立於民國83年01月07日，主要從事半導體設備關鍵性及消耗性零組件製造，主要產品包含 Retaining Ring(晶圓夾持環)、Susceptor (晶圓承載盤)、Collimator(準直器)、Heater(加熱器)及 Shower Head(電漿分流器)等，是半導體設備大廠的合格供應商，在半導體設備零組件產業深耕多年，曾獲台積電(股)公司、華邦電子(股)公司頒獎肯定。慶康科技專精於精密加工、表面處理、陶瓷噴塗、電漿工程，亦具設備設計及自製的專業工程能力，這能力更充分展現在慶康科技公司的製造設備自動化、檢驗設備優化等，建立了競爭優勢。慶康科技公司將以提供 CMP(Chemical-Mechanical Polishing, 化學機械研磨) 製程設備零件 Total Solution 為宗旨，滿足客戶需求、為客戶提供專業、快速、高品質的產品。

二、歷史沿革

時間	重要沿革
83年	1.在新竹科學園區設立。 2.研發製造人工骨骼，並成功銷售予國外人工骨骼公司。
84年	1.研發製造出鈦合金及鈷合金的高精度人工髖關節，並成功銷售予美國人工骨骼公司。 2.將半導體設備零組件及次系統件增列入營業項目，積極開發製造半導體製程設備內

	的機械零組件。
85年	1.半導體零組件之技術有重大突破，產品順利銷售至新加坡、韓國和日本，並獲台積電頒獎表揚。 2.限於廠房面積，暫時中止人工骨骼業務。
86年	1.成功開發陽極處理鋁合金零件、表面電漿噴焊(Plasma Spray)零件、精密陶瓷零件等半導體設備零組件，並積極開發 Susceptor、Heater、E-Chuck 等半導體設備次系統件。 2.執行竹科創新產品研發案「乾式蝕刻機上電極板開發」。 3.加入清華大學「12吋晶圓高密度電漿源開發」產學計畫。 4.辦理現金增資，增資後實收股本 NT\$118,093 千元。 5.自華邦電子(股)公司購入煙害八吋晶圓全廠設備，藉由翻修學習半導體設備之設計。
87年	1.成功開發高密度電漿金屬蝕刻機集束傳輸設備(Cluster Tool)。 2.使用在物理氣相沉積(PVD)設備之鈦合金準直管(Collimator)開發成功。 3.辦理現金增資，增資後實收股本 NT\$182,000 千元。
88年	1.執行經濟部所屬事業協助中小企業推動研究發展計畫「電漿蝕刻機靜電吸盤開發」。 2.執行新竹科學園區創新技術研究發展案「電漿輔助化學氣相沉積機台用電阻加熱式晶片載台開發」。 3.BGA 電漿清洗機(BGA Plasma Cleaner)開發成功。 4.辦理增資，增資後實收股本 NT\$250,000 千元。
89年	1.執行業界科專「BGA 基板電漿清洗技術開發」。 2.大面積高密度電漿源技術突破，並申請專利。 3.辦理現金增資，增資後實收股本 NT\$268,000 千元。 4.七月首次申請補辦公開發行。
90年	1.執行關鍵零組件及產品開發計畫「氟氣碳尾氣電漿反應系統開發計畫」。 2.業界科專「BGA 基板電漿清洗技術開發」執行結案。 3.南科廠第一期動土。
91年	1.南科廠 A 棟廠房落成陸續啟用。 2.華邦煙害設備專案結案。
92年	1.南科廠通過 ISO 國際認證。 2.召開協力廠商研討會。 3.三月申請興櫃、四月興櫃掛牌、十二月撤興櫃及撤銷公發。
97年	1.成功建立高能束流表面處理製程。 2.成功開發出「旋轉陰極」(Rotatable Cathode)，可應用在大尺寸玻璃(2.54x3.66m)上，以 PVD 鍍膜。 3.南科廠通過 ISO 9001:2000 國際認證。
98年	1.成功建立真空仟焊製程。 2.成功建立電漿噴塗(Plasma Spray)製程。 3.成功取得客戶加熱器訂單。 4.與中山大學材料與光電科學系產學合作，執行國科會固本精進研究計畫-高效率 CdTe 薄膜太陽電池之研製。
99年	1.開始大尺寸之 PECVD 及蒸鍍(Evaporation)設備開發。
100年	1.國科會固本精進研究計畫-高效率 CdTe 薄膜太陽電池之研製專案結案驗收。
101年	1.竹科整合南竹科產線、提高競爭力，註銷竹科廠。 2.依公司法第167之1條規定註銷1,340仟股，註銷後實收股本 NT\$254,600 千元。
103年	1.開始200mm 第二代加熱器(Heater)研發。
104年	1.南科廠通過國際客戶濕法製程認證。
105年	1.成功開發 200mm 第二代加熱器(Heater)。 2.獲勞動部勞動力發展署 TTQS 人才發展品質管理評核(企業機構版)銅牌。
107年	1.南科廠 B 棟廠房動土。
108年	1.通過 ISO 9001:2015 國際認證。

109年	1.成功開發熱噴塗靜電吸盤(E-Chuck)。 2.南科廠 B 棟廠房落成啟用。 3.規劃於 A 棟、B 棟廠房屋頂設置太陽光電發電設備系統。 4.依公司法第167之1條規定註銷420仟股，註銷後實收股本 NT\$250,400千元。
110年	1.現金減資15,040仟股，現金減資後實收股本 NT\$100,000千元。
111年	1.南科廠通過國際客戶組件製造認證。 2.成功建立 HFCVD(Hot Filament Chemical Vapor Deposition，熱燈絲化學氣相沉積)工程能力。 3.正式取得太陽光電發電設備系統售電收入。 4.依公司法第167之1條規定註銷198仟股，註銷後實收股本 NT\$98,019,730元。

三、經營理念

慶康科技期許追求更卓越的生產技術，並以世界級的品質自許，秉持且實踐「誠信、精緻、勤奮、永續」的經營理念，與世界各地的客戶建立良好的關係。

四、未來展望

1、短期業務發展計畫

深耕既有的客戶，提供最佳的服務和技術解決方案，持續製程優化提升品質，拓展新客戶、擴大產能滿足客戶的需求，並藉由投入開發半導體 CMP (Chemical-Mechanical Polishing，化學機械研磨)設備上的 Conditioner(修整器)，拓展產品線。

2、長期業務發展計畫

建立智慧化生產線的工廠，整合精密機械加工及自動化控制技術，持續擴大市占率、開拓新市場，設立海外據點，擴大服務至國際各大半導體廠商。

風險事項說明(登錄戰略新三板公司適用)

慶康科技股份有限公司係依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第三章規定申請股票登錄戰略新三板之公司，相關營運風險較高，且戰略新三板市場參與者之買方限合格投資人，請投資人特別注意。

產業風險

本公司主要從事半導體製程所需關鍵零組件之研發、製造及銷售，終端應用客戶為晶圓製造大廠，由於半導體產業景氣易受電子產品供需及景氣影響，尤其當總體經濟衰退導致消費意願低迷時，電子類產品銷售首當其衝，而終端需求減少時易使半導體機台設備稼動率降低，影響設備耗材之更換頻率，進而影響本公司零組件之銷量。

營運風險

由於半導體前段製程設備產業有其獨特性，具有技術不斷創新、高度寡占及客戶集中度高等特性，加上係屬資本密集行業，設備廠商不斷透過併購之整合策略，達到大者恆大之趨勢。而本公司銷售之客戶及終端應用廠商對象別大多為半導體設備或晶圓廠等國際大廠為主，且因銷售對象數量有限，易產生銷貨集中之情事。

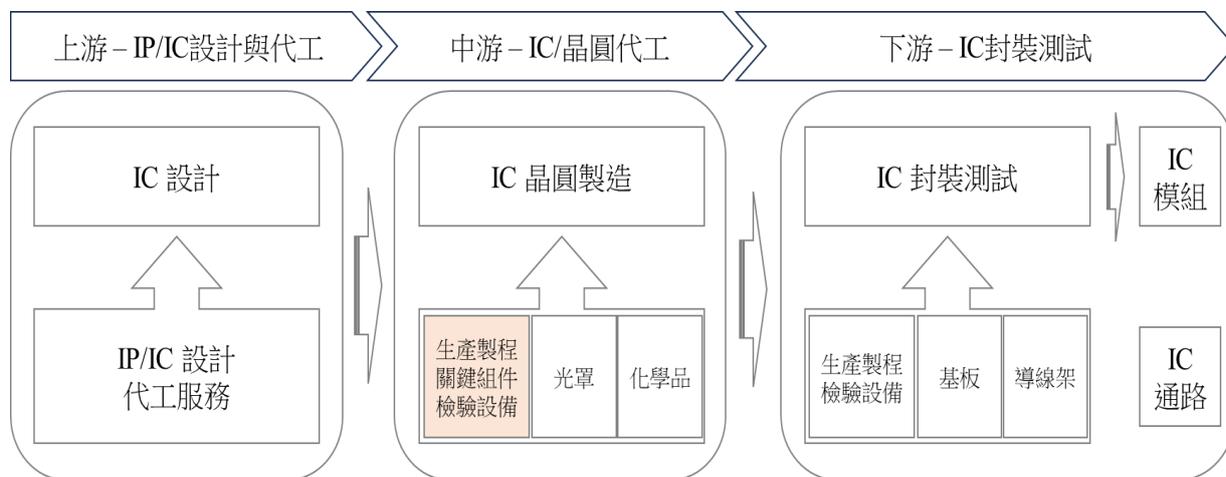
TOP ^

主要業務項目：

主要係從事半導體製程設備的關鍵性及消耗性零組件之研發、製造及銷售。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

本公司為半導體產業中游-晶圓及 IC 製造製程所需關鍵及消耗性零組件之製造供應廠商，為先進製程發展的重要協作廠商，產品主要係銷售予半導體設備商，終端應用客戶為晶圓廠及 DRAM 廠為主。



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
半導體製程設備關鍵性、消耗性零組件(包含 Retaining Ring(晶圓夾持環)、Susceptor(晶圓承載盤)、Heater(加熱器)、Shower Head(電漿分流器)及 Collimator(準直器)等)		提供各種晶圓製程設備所需的關鍵性、消耗性零組件，協助客戶以穩定的高品質、高稼動率、低生產成本、低等待及低汰換週期，使設備順利運轉以產出品圓。	506,110	100%
合 計			506,110	100%

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年 (註1)	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年截至9月份止 (自結數)(註2)
	營業收入		301,398	280,558	266,686	391,402	506,110
營業毛利		119,122	82,650	83,318	149,927	231,433	116,071
毛利率(%)		39.52	29.46	31.24	38.31	45.73	45.36
營業外收入		18,683	10,224	6,744	1,113	57,327	35,239
營業外支出		(6,676)	(10,403)	(24,726)	(11,455)	(1,512)	(3,067)
稅前損益		89,583	46,126	36,025	103,862	256,798	116,530
稅後損益		74,623	37,180	29,146	83,701	203,089	85,828
每股盈餘(元)		3.78	1.80	1.32	4.25	21.03	8.76
股利發放	現金股利(元)	0.7	0.7	-	-	3.0	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-

註1：各期係經會計師查核簽證之財務報告並採用國際財務報導準則編制；107~109年度揭露金額係為依我國企業會計準則編制之財務報告。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		107年 (註)	108年 (註)	109年 (註)	110年 (註)	111年 (註)
項目						
流動資產		568,513	576,531	517,861	536,654	688,203
基金及長期投資		33,547	39,749	35,646	5,918	1,879
固定資產		153,227	178,823	261,101	264,949	261,677
無形資產		1,042	1,242	510	-	-
其他資產		10,073	12,546	12,970	55,199	63,798
資產總額		766,402	808,891	828,088	862,720	1,015,557
流動負債	分配前	193,294	186,616	202,576	243,514	191,629
	分配後	176,363	169,685	202,576	243,514	162,223
長期負債		10,136	35,000	25,000	15,000	5,000
其他負債		13,647	69	53	41,535	39,460
負債總額	分配前	217,077	221,685	227,629	300,049	236,089
	分配後	200,146	204,754	227,629	300,049	206,683
股本		254,600	254,600	250,400	100,000	98,020
資本公積		795	3,109	4,386	14,094	27,863
保留盈餘	分配前	341,747	361,996	374,211	457,912	661,001
	分配後	324,816	345,065	374,211	457,912	631,595
其他權益		(9,789)	(8,600)	(7,615)	(7,999)	(7,416)
庫藏股票		(38,028)	(23,899)	(20,923)	(1,336)	-
股東權益總額	分配前	549,325	587,206	600,459	562,671	779,468
	分配後	532,394	570,275	600,459	562,671	750,062

註：各期係經會計師查核簽證之財務報告並採用國際財務報導準則編制；107~109年度揭露金額係為依我國企業會計準則編制之財務報告。

最近三年度財務比率

年度		109年	110年	111年
項目				
財務比率	毛利率(%)	31.24	38.31	45.73
	流動比率(%)	255.64	220.38	359.13
	應收帳款天數(天)	51.45	45.98	47.76
	存貨週轉天數(天)	169.00	144.35	151.60
	負債比率(%)	27.49	34.78	23.25

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)